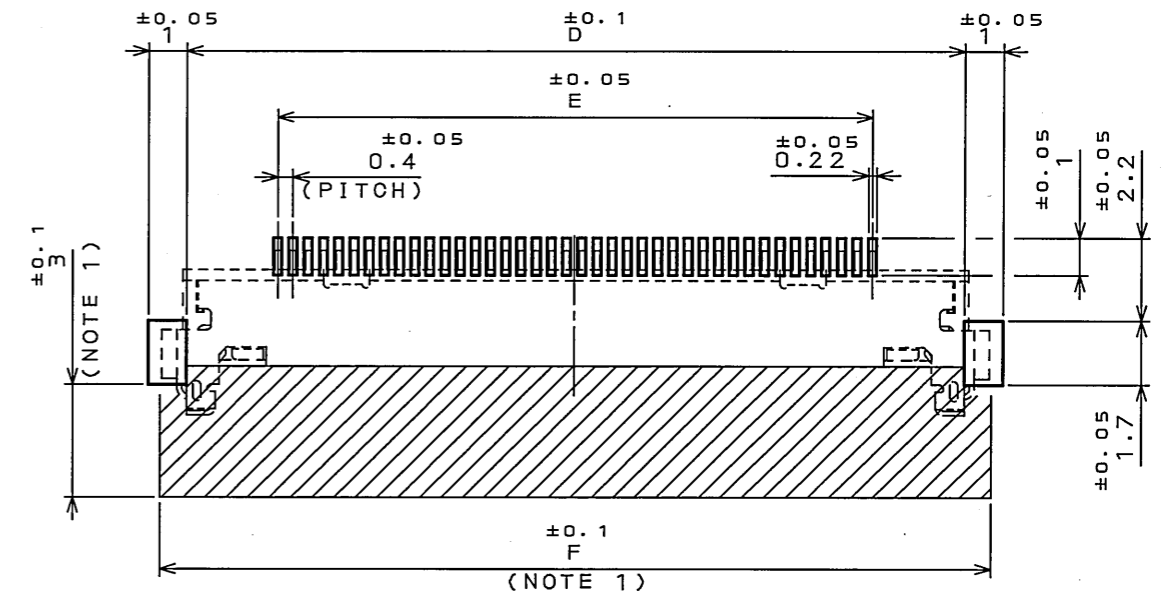
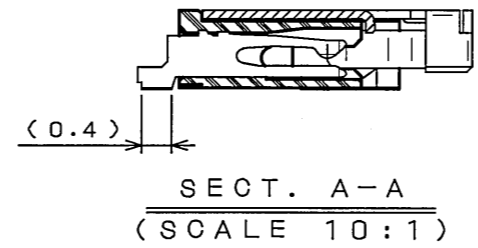
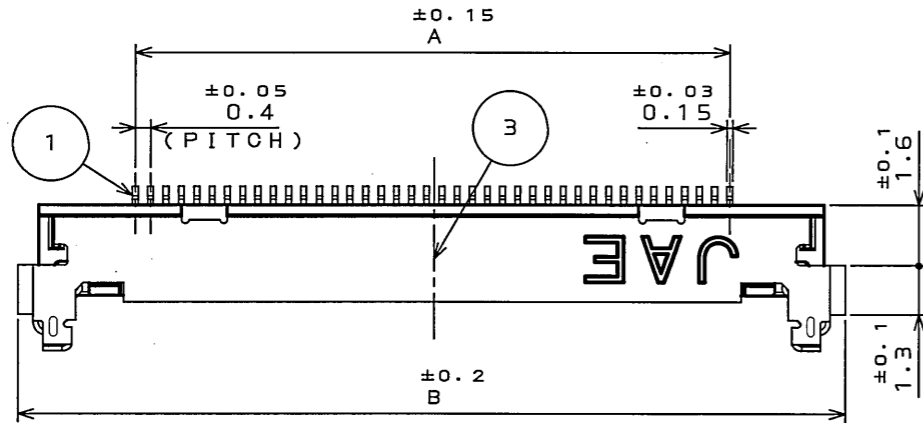
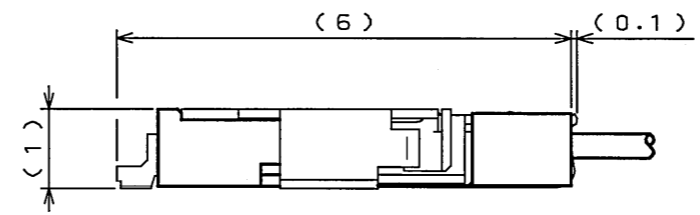
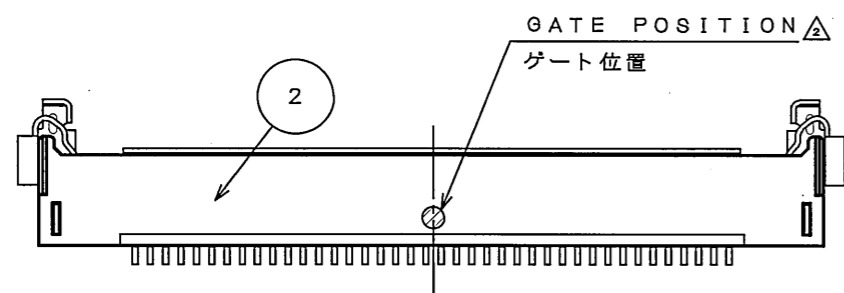
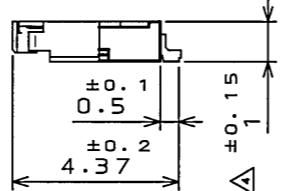
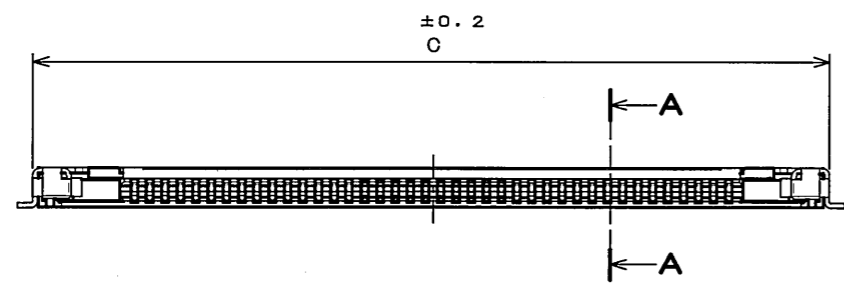


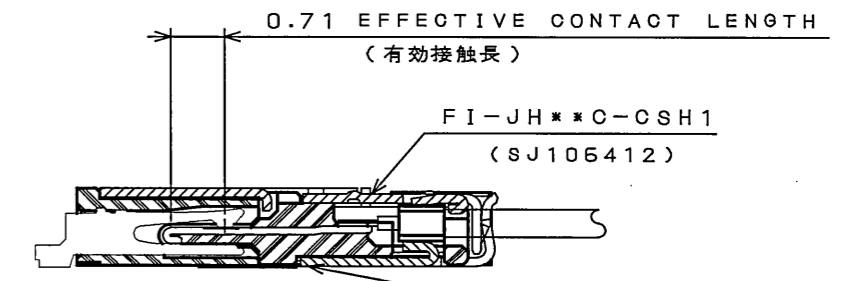
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23.Oct.2006	061405	ADDING PRODUCT NAME AND GATE POSITION		T.TSUJI		Y.TATEBE
3	30.Oct.2006	061457	ERROR CORRECTION		T.TSUJI	M.SUZUKI	K.HISATOMI
4	1.Feb.2008	064958	REVISED TOLERANCE		T.TSUJI	M.KIKUCHI	K.HISATOMI



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)



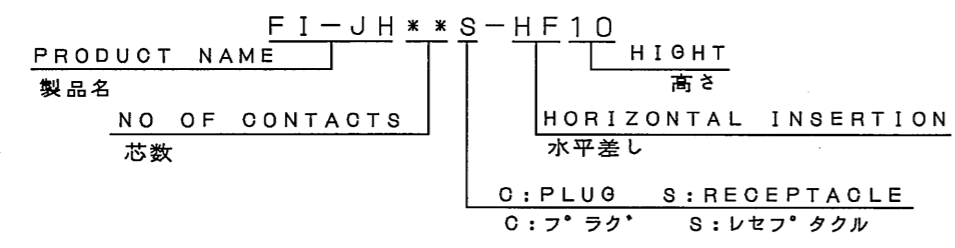
MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態 (参考)



SECT. OF MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態断面図 (参考)

Pin NO.	A	B	C	D	E	F
40	15.6	21.7	20.9	20.4	15.6	21.8
30	11.6	17.7	16.9	16.4	11.6	17.8

NOTE 1. THIS AREA IS GROUND-PATTERN ONLY.
2. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN SHOULD BE 0.1mm MAX.
3. PRODUCT NAME IS MARKED AS SHOWN IN BELOW FIGURE MARKING.
注 1. この範囲は、プラグコネクタのシェルが接触する為、パターン及びスルーホール不可とする。但し、グランドは可とする。
2. 端子および、ホールダウンの相互のパラツキは0.1mm以内とする。
3. 製品名の表記方法は下記による。



3	COVER SHELL カバーシェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	CONTACT AREA: GOLD (0.03 μm MIN) OVER NICKEL 接触部: NI上Au (0.03 μm以上)メッキ	
2	INSULATOR インシュレータ	1	HAET RESISTING PLASTIC 耐熱性樹脂		
1	CONTACT コンタクト	**	COPPER ALLOY 銅合金	CONTACT AREA: GOLD (0.1 μm MIN) OVER NICKEL 接触部: NI上Au (0.1 μm以上)メッキ	TERMINAL AREA: GOLD (0.03 μm MIN) OVER NICKEL
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 20.Jun.2006	尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) FI-JH	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. H.ABE	名称 (TITLE) FI-JH***S-HF10			
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	担当 CHK. T.TSUJI	(PCB SIDE)			
公差 (DIMENSION)	査閲 APPD. M.KIKUCHI				
公差 (DIMENSION)	承認 APPD. K.HISATOMI				
質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ106787	版数 (REV.) 4

DOF-0-212F(05.08)

